

# 10 電子部品実装はんだ周り欠陥

元件封装焊料周围的缺陷 / Defective solder joints for component mounting

## 10-1 実装に伴う欠陥／封装时的缺陷 / Defects related to component mounting

### 10-1-1 リフトオフ／剥离 / Lift-off

【特徴】ランドとはんだフィレット間が剥離してその部分が浮き上がっている状態の欠陥

【特征】焊环与焊脚分离，该部分浮起的缺陷。

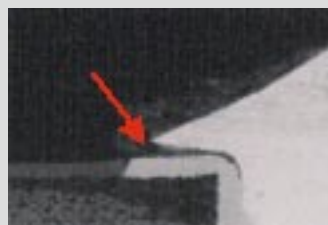
【Characteristics】A solder fillet is lifted off and separated from the land.

【起因・判断ポイント・発生工程】部品実装時または熱衝撃試験などでの熱ストレスや、それにより発生した機械的応力の影響を受けて出来たもの（電子部品実装工程、熱衝撃試験）※ただしこの現象は、進行性がないため現在のところ不良としては扱われていない。

【原因、判断要点、発生工序】受元件封装或者热冲击试验时等的热应力，以及机械应力的影响所引起的（元件封装工序、热冲击试验）※但是，这种现象没有重复性，目前不作为不良处理。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by thermal stress and/or mechanical stress involved in component mounting or thermal shock testing (Component mounting process and thermal shock testing)

Note: As this phenomenon is not progressive, this phenomenon is not considered as a defect now.



【コメント】  
断面  
顕微鏡倍率 × 200

【注釋】  
截面  
显微镜倍率 × 200

【Comments】  
Microsection  
Magnification: ×200



【コメント】  
外観  
顕微鏡倍率 × 75

【注釋】  
外观  
显微镜倍率 × 75

【Comments】  
Appearance  
Magnification: ×75



【コメント】  
断面  
顕微鏡倍率 × 35

【注釋】  
截面  
显微镜倍率 × 35

【Comments】  
Microsection  
Magnification: ×35



【コメント】  
外観  
顕微鏡倍率 × 75

【注釋】  
外观  
显微镜倍率 × 75

【Comments】  
Appearance  
Magnification: ×75